



2022年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2021年8月4日

上場会社名 テクノクオーツ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 5217 URL <http://www.techno-q.com>
 代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 園田育伸
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 岸 慎二 (TEL) 03-5354-8171
 四半期報告書提出予定日 2021年8月6日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2022年3月期第1四半期の連結業績(2021年4月1日～2021年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年3月期第1四半期	3,820	26.5	849	38.5	816	30.7	553	27.8
2021年3月期第1四半期	3,020	31.7	613	48.0	624	54.9	432	44.9

(注) 包括利益 2022年3月期第1四半期 792百万円(126.0%) 2021年3月期第1四半期 350百万円(3.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2022年3月期第1四半期	715.34	—
2021年3月期第1四半期	559.53	—

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第1四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2022年3月期第1四半期	15,795	11,791	74.7
2021年3月期	15,273	11,254	73.7

(参考) 自己資本 2022年3月期第1四半期 11,791百万円 2021年3月期 11,254百万円

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、2022年3月期第1四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2021年3月期	—	0.00	—	330.00	330.00
2022年3月期	—	—	—	—	—
2022年3月期(予想)	—	0.00	—	330.00	330.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2022年3月期の連結業績予想(2021年4月1日～2022年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	6,530	5.4	1,260	△1.2	1,260	△1.4	890	1.5	1,150.72
通期	13,100	2.4	2,460	0.6	2,460	3.9	1,740	8.3	2,249.73

(注) 1 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

2 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、上記の連結業績予想は、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)

2022年3月期1Q	780,000株	2021年3月期	780,000株
------------	----------	----------	----------

② 期末自己株式数

2022年3月期1Q	6,573株	2021年3月期	6,573株
------------	--------	----------	--------

③ 期中平均株式数 (四半期累計)

2022年3月期1Q	773,427株	2021年3月期1Q	773,514株
------------	----------	------------	----------

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	5
四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
3. 補足情報	8
(1) 生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国及び世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、企業業績は一部回復の動きがみられるものの依然として先行きは不透明であり、全般的な経済活動の持ち直しには時間を要する状況となりました。

半導体業界におきましては、5GやAI、IoT、自動運転等の需要がますます高まるなかで、半導体の供給不足による生産のタイト感も強まっております。こうした需給状況は当分続くものと思われ、各メーカーの投資意欲も継続しており、半導体市場は今後も着実に拡大していくものと見込まれます。

このような環境の中、当社では、これまでに蓄えた豊富な受注残高と、工場の高稼働に伴う量産効果を背景に、売上高、利益ともに計画を上回ることが出来ました。また、受注残高につきましては、2019年秋頃から拡大傾向に転じた後、コロナ禍においても拡大を続け、足元では過去最高レベルの水準で推移している状況です。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は3,820百万円（前年同期比26.5%増）、営業利益は849百万円（同38.5%増）、経常利益は816百万円（同30.7%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は553百万円（同27.8%増）となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等の適用により、当第1四半期連結累計期間の売上高は4百万円減少しております。

当社グループの事業は、半導体事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に記載された区分ごとの状況の分析は省略しております。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ521百万円増加して15,795百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金が174百万円、有形固定資産が559百万円それぞれ増加し、現金及び預金が221百万円減少したこと等であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ15百万円減少して4,004百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が92百万円、借入金が178百万円それぞれ増加し、未払法人税等が298百万円減少したこと等であります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ536百万円増加して11,791百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が298百万円、為替換算調整勘定が247百万円それぞれ増加したこと等であります。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,477,344	3,255,810
受取手形及び売掛金	3,344,309	3,518,433
製品	420,326	345,735
仕掛品	1,210,883	1,349,955
原材料及び貯蔵品	1,280,308	1,141,798
その他	144,667	217,094
貸倒引当金	△4,686	△1,515
流動資産合計	9,873,154	9,827,312
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,341,130	1,343,103
機械装置及び運搬具（純額）	1,523,999	1,524,669
土地	1,148,302	1,148,337
リース資産（純額）	183,193	174,994
建設仮勘定	551,914	1,130,186
その他（純額）	172,845	159,375
有形固定資産合計	4,921,383	5,480,665
無形固定資産	242,524	263,158
投資その他の資産		
その他	237,690	225,414
貸倒引当金	△876	△868
投資その他の資産合計	236,814	224,546
固定資産合計	5,400,722	5,968,371
資産合計	15,273,876	15,795,683

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	978,278	1,070,550
短期借入金	981,748	1,204,268
未払法人税等	499,286	200,970
賞与引当金	186,607	87,262
その他	366,623	406,757
流動負債合計	3,012,542	2,969,809
固定負債		
長期借入金	681,081	637,364
役員退職慰労引当金	26,944	29,186
退職給付に係る負債	133,066	146,092
その他	165,477	221,561
固定負債合計	1,006,568	1,034,204
負債合計	4,019,111	4,004,013
純資産の部		
株主資本		
資本金	829,350	829,350
資本剰余金	1,015,260	1,015,260
利益剰余金	9,174,802	9,472,838
自己株式	△38,026	△38,026
株主資本合計	10,981,386	11,279,422
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△2,222	△11,021
為替換算調整勘定	275,600	523,268
その他の包括利益累計額合計	273,377	512,247
純資産合計	11,254,764	11,791,670
負債純資産合計	15,273,876	15,795,683

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年6月30日)
売上高	3,020,869	3,820,065
売上原価	2,118,103	2,622,542
売上総利益	902,766	1,197,523
販売費及び一般管理費	289,462	348,204
営業利益	613,303	849,318
営業外収益		
受取利息	239	178
受取配当金	520	730
為替差益	11,093	—
保険戻戻金	789	3,423
その他	1,559	439
営業外収益合計	14,201	4,771
営業外費用		
支払利息	2,573	2,366
為替差損	—	33,408
その他	8	1,402
営業外費用合計	2,581	37,177
経常利益	624,923	816,913
特別損失		
固定資産除却損	370	1,009
特別損失合計	370	1,009
税金等調整前四半期純利益	624,552	815,903
法人税、住民税及び事業税	160,164	188,464
法人税等調整額	31,583	74,171
法人税等合計	191,748	262,636
四半期純利益	432,804	553,266
親会社株主に帰属する四半期純利益	432,804	553,266

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
四半期純利益	432,804	553,266
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△441	△8,798
為替換算調整勘定	△81,785	247,667
その他の包括利益合計	△82,227	238,869
四半期包括利益	350,577	792,136
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	350,577	792,136

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

当社グループは半導体事業の単一セグメントであります。

① 生産実績

セグメントの名称	生産高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	3,828,729	38.0

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 金額は消費税等を含んでおりません。

② 受注実績

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	3,880,894	14.7	4,263,052	7.3

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。

③ 販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同期比(%)
半導体事業	3,820,065	26.5

(注) 金額は消費税等を含んでおりません。